

中国电子电路行业协会

第38期

信息部

2023年12月29日

一、行业

国家统计局：11月份全国规模以上工业企业利润同比增长 29.5%

12月27日电，国家统计局发布的数据显示，11月份，全国规模以上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。1-11月份，全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1-10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。近六成行业利润增长，八成行业利润增速回升。1至11月份，在41个工业大类行业中，有24个行业利润同比增长，利润增长面为58.5%，较1至10月份扩大14.6个百分点；有33个行业利润增速较1至10月份加快或降幅收窄、由降转增，利润回升面为80.5%，较1至10月份扩大7.3个百分点。（新华社）

五部门发文：预计到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型

12月27日，国家发改委等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。

（新华社）

中国贸促会：全球经贸摩擦有加剧趋势

12月25日，中国贸促会发布10月全球经贸摩擦指数。从综合指数看，当月全球经贸摩擦指数为305，继续处于高位区间，比上年同期上升44个点，比上月上升124个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升29%，环比上升43.6%，全球经贸摩擦有加剧趋势。在涉华经贸摩擦方面，19个国家（地区）涉华经贸摩擦指数为1426，处于高位，较上月上升94个点，其中，美国最高，其次是土耳其，欧盟排名第三。当月19个国家（地区）涉华经贸摩擦措施涉及金额同比上升23.2%，环比上升77.1%。电子、机械设备、轻工、医药

和运输设备行业涉华经贸摩擦指数处于高位。（中国贸促会）

人民政协网：2023 年东盟总体营商环境稳中有升

12 月 27 日，据中国贸促会《东盟营商环境报告 2023》，中国与东盟连续 3 年互为最大贸易伙伴。2023 年东盟总体营商环境稳中有升，报告显示，企业普遍认为，新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚的营商环境在东盟中排名较为靠前。2023 年中资企业在东盟的总体经营情况较好。调查显示，51.11%的受访企业预期 2023 年在东盟经营将实现盈利，分别有 48.88%、48.6%和 51.41%的受访企业预计 2023 年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加，拟扩大在东盟业务的企业占比达 70.95%。企业对东盟营商环境仍有不少期待：一是希望东盟成员持续改善营商环境。二是加大力度高质量实施 RCEP，进一步提高贸易投资自由化便利化水平。三是进一步提升外资政策稳定性和公平性，营造公平竞争的市场环境。四是不断加强物流、数字、能源电力等基础设施建设，推动绿色经济发展。（人民政协网）

《上海海关支持集成电路产业发展监管创新实施办法》发布

12 月 26 日，上海海关正式对外发布《集成电路产业监管创新实施办法（2.0 版）》（以下简称《实施办法（2.0 版）》），全面覆盖芯片设计、芯片制造、封装测试、设备制造和物流

供应链等全部环节以及各类企业主体。《实施办法（2.0版）》聚焦创新政策更好覆盖全产业链，聚焦关键主体更好发挥引领作用，聚焦关键环节更好提升韧性，聚焦关键领域更好降本增效，将为集成电路产业链供应链注入新的动能，进一步推动上海集成电路产业集群实现高质量发展。（上海海关）

二、市场

1-11月，我国电动汽车、锂电池、太阳能电池等产品出口分别达到2693亿元、4194亿元和2890亿元

12月26日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍相关情况。会上，国家知识产权局局长申长雨表示，随着我国科技创新能力的持续增强，我国在新产业新赛道领域的竞争优势不断彰显，特别是以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的绿色低碳产业加快发展。数据显示，今年前11个月，我国电动汽车、锂电池、太阳能电池等产品出口分别达到2693亿元、4194亿元和2890亿元，呈现出良好的发展势头，相关产品在全球市场占有率也在持续提升。（国家知识产权局）

12月1-24日新能源车市场零售56.7万辆，较上月同期增长10%

12月27日，乘联会发布的数据显示，12月1-24日，乘

用车市场零售 152.5 万辆，同比去年同期增长 7%，较上月同期增长 20%，今年以来累计零售 2086.9 万辆，同比增长 5%；全国乘用车厂商批发 152.3 万辆，同比去年同期增长 17%，较上月同期增长 5%，今年以来累计批发 2433.8 万辆，同比增长 9%。12 月 1-24 日新能源车市场零售 56.7 万辆，同比去年同期增长 22%，较上月同期增长 10%，今年以来累计零售 737.5 万辆，同比增长 34%；全国乘用车厂商新能源批发 65.5 万辆，同比去年同期增长 34%，较上月同期增长 7%，今年以来累计批发 842.8 万辆，同比增长 35%。（乘联会）

中国信通院：11 月国内市场手机出货量同比增 34.3%

12 月 27 日，中国信通院网站发布数据显示，2023 年 11 月，国内市场手机出货量 3121.1 万部，同比增长 34.3%。2023 年 11 月，国内市场手机出货量 3121.1 万部，同比增长 34.3%，其中，5G 手机 2709.2 万部，同比增长 51.2%，占同期手机出货量的 86.8%。2023 年 1-11 月，国内市场手机总体出货量累计 2.61 亿部，同比增长 7.1%，其中，5G 手机出货量 2.15 亿部，同比增长 12.9%，占同期手机出货量的 82.5%。（中国信通院）

三、企业

澳弘电子拟发行可转债募资 5.8 亿元,用于泰国生产基地建设项目

12月22日,澳弘电子发布公告,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超过5.8亿元,用于泰国生产基地建设项目,该项目由公司泰国子公司泰国澳弘负责实施,计划总投资金额为5.96亿元,计划建设实施周期为24个月。公告显示,澳弘电子计划在泰国巴真武里府金池工业园购置土地并自建厂房,通过购置先进的生产设备,建设印制电路板(PCB)生产基地,旨在提升公司的整体生产能力以及完善海外产能布局,从而填补公司海外产能的空白,以满足公司海外客户日益增长的订单需求。项目达产后将形成年产120万m²双面板和多层板的生产能力,届时公司的整体生产能力、产能布局、产品线结构等都将得到进一步优化。(证券时报网)

消息称台积电熊本厂进度顺利,或将于明年2月开幕

12月26日,有供应链方面消息表示,台积电日本熊本厂进度顺利,暂规划2024年2月举行开幕典礼。台积电熊本工厂一期采用12/16、22/28纳米特殊制程,预计2024年底进入量产,2023年10月已开始移入机器设备,并开始试

产。（台湾《电子时报》）

以色列批准英特尔投资 250 亿美元建芯片工厂

12月26日，以色列财政部、经济部和税务局26日发表联合声明，宣布批准美国英特尔公司在该国投资250亿美元新建芯片工厂。声明说，这是以色列史上外国公司在该国最大的一笔投资，工厂将建在以南部加特镇，并雇用数千名工作人员。英特尔承诺在2028年前完成投资并启用该工厂，且至少运营至2035年。根据以色列鼓励投资相关法律，英特尔将获得投资额12.8%的补助，即32亿美元。英特尔自上世纪70年代开始在以色列开展业务，目前在以色列设有3个研发中心和一座工厂，总共雇用约1.2万名员工。（新华网）

上交所新增受理和美精艺科创板上市申请

12月27日，深圳和美精艺半导体科技股份有限公司在上交所更新上市申请审核动态，该公司IPO申请已受理。公司本次公开发行新股不超过5,915.50万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次募投项目将通过引进更加先进的显影、曝光、蚀刻、成型、检测等设备，提高IC封装基板生产和检测过程的精度，实现更高制程技术的突破。项目的实施将有助于提升公司IC封装基板产品的工艺技术水平，实

现产品的高端技术突破，并形成稳定的批量生产能力，打破境外企业对高端 IC 封装基板的技术和市场垄断，提高公司产品的市场地位。（证券时报网）

三星电子将美国泰勒新晶圆厂的量产时间推迟至 2025 年

12 月 26 日，据 Business korea 报道，三星电子将位于美国得克萨斯州泰勒的新半导体工厂的量产启动时间推迟到了 2025 年，而最初目标是明年开始量产。推迟的原因据推测与美国政府补贴和各种许可证复杂性问题有关，经济复苏的不确定性也似乎影响了三星电子在该地区的投资决策。三星电子代工业务负责人 Siyoung Choi 在 2023 年国际电子器件会议上发表讲话称，三星电子将其位于美国得克萨斯州泰勒的新工厂的量产时间从 2024 年推迟至 2025 年，泰勒工厂将于明年下半年产出首片晶圆。这标志着与 2021 年最初投资时宣布的原计划相比发生了重大转变，原计划是在 2024 年下半年实现量产。（IT 之家）

英伟达支付数亿美元预付款锁定产能 HBM 有望维持超高景气

12 月 28 日，据财联社，英伟达为了确保 HBM 稳定供应，已向 SK 海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已

确定供应合约。三星电子近期也结束产品测试，与英伟达签订 HBM 产品供应协议。大模型的推理和训练是内存密集型工作，从内存中存储和检索数据的能力将制约 AI 芯片性能的发挥，即内存墙。HBM 在传统 DDR 内存和片上缓存的基础上，通过大幅增加引脚数量以达到每个 HBM 堆栈 1024 位宽的内存总线，实现了更高的带宽，相当于每个 DIMM 64 位宽的 DDR5 的 16 倍，从而解决了内存墙的问题。Omdia 研究显示，从 2023 年到 2027 年，DRAM 市场收入的年增长率预计为 21%，而 HBM 市场预计将飙升 52%。HBM 今年在 DRAM 市场收入中的份额预计将超过 10%，到 2027 年将接近 20%。（财联社）

MGC Electrotechno（泰国）有限公司在 WHA 伟华东海岸工业区一区扩建工厂

12 月 27 日，MGC Electrotechno（泰国）有限公司在 WHA 伟华东海岸工业区一区扩建工厂。MGC Electrotechno（泰国）有限公司举行的工厂扩建庆功仪式，该仪式的举行标志着 MGC Electrotechno（泰国）有限公司在泰国的第二次产能扩张正式开始。新扩建工厂的工厂位于 WHA 伟华东海岸工业区一区，预计在 2025 年内实现运营，新工厂建成投产后将主要生产印刷电路板（预浸料、覆铜层压板）等材料。（伟华工业园）